

NUMBER 178305

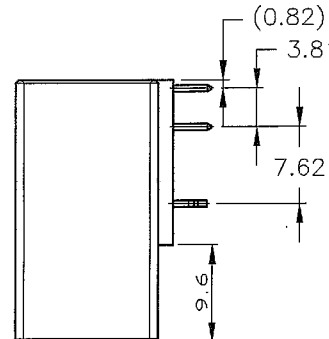
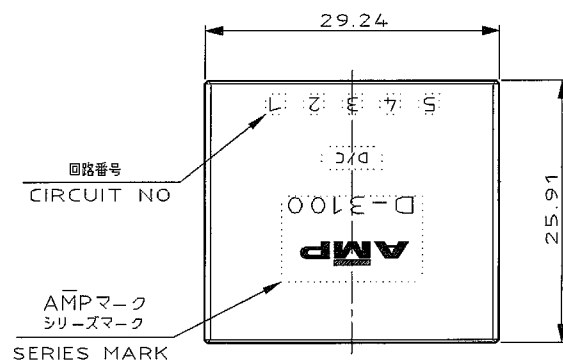


METRIC

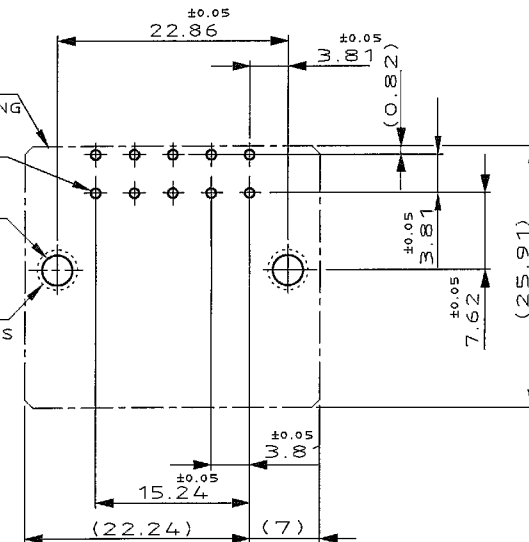
DIMENSIONS IN MILLIMETERS. DO NOT SCALE PRINT

PRINT DIST

AMP-J
REV.10/83



コネクタ外形
OUTLINE OF HEADER HOUSING
10-φ1.1
DIA 1.1±0.1 10 PLACES
スルーホール 2-φ3
DIA 3±0.1 2 PLACES
ラウンド 2-φ4 MIN
ROUND DIA 4 MIN 2 PLACES

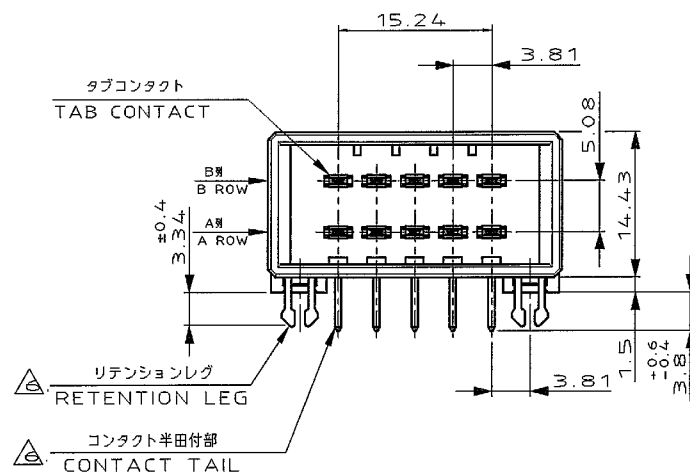


推奨基板取付け寸法

PC 基板厚: 1.6±0.1
(非累積公差)
(コネクタ搭載面)

RECOMEND PC BOARD HOLE PATTERN

PC BOARD THICKNESS: 1.6±0.1
(NOT ACCUMULATE TOLERANCE)
(CONNECTOR MOUNT SIDE)



NOTES

1. MATERIAL: HOUSING: GLASS FILLED THERMO PLASTIC, POLYESTER
CONTACT: COPPER ALLOY
RETENTION LEG: COPPER ALLOY
2. FINISH (CONTACT AREA): 0.38 μm MIN GOLD PLATING OVER Ni PLATING
3. FINISH (CONTACT AREA): 0.76 μm MIN GOLD PLATING OVER Ni PLATING
4. FINISH (CONTACT AREA): 2.0 μm MIN TIN PLATED OVER NICKEL
5. FINISH (RETENTION LEG): TIN-LEAD PLATED (CONTACT TAIL) OVER NICKEL
6. FINISH (RETENTION LEG): TIN PLATED (CONTACT TAIL) OVER NICKEL

注 記

1. 材料: ハウジング: ガラス入り熱可塑性
ポリエスチル樹脂
コンタクト: 銅合金
リテンションレグ: 銅合金
2. めっき: コンタクト: 全面Ni下地
接触部: 0.38 μm MIN金めっき
3. めっき: コンタクト: 全面Ni下地
接触部: 0.76 μm MIN金めっき
4. めっき: コンタクト: 全面Ni下地
接触部: 2.0 μm MINスズめっき
5. めっき: リテンションレグとコンタクト半田付部: ニッケル下地の下に半田めっき
6. めっき: リテンションレグとコンタクト半田付部: ニッケル下地の下にスズめっき

△6	△4	178305-5
△6	△3	178305-3
△6	△2	178305-2
(FINISH)		製品番号 (PART NO.)

C	B	A	O	LTR
REVISED (FJ00-0039-03)	REVISED (FJ00-0097-03)	REVISED (FJ00-2183-95)	RELEASED (J-1184)	REVISION RECORD
T S S M	T S S M	K I S M	N M	DR
4/15/93	4/15/93	3-23/95	3-4/92	CHK
DATE	DATE	DATE	DATE	DATE

Copyright © 1991 AMP (Japan) LTD. ALL RIGHTS RESERVED.		tyco Electronics		Tyco Electronics AMP K.K. Kawasaki, Japan	
WIRE RANGE mm (AWG)		INSULATION DIA mm		NAME ダイナミック D3100 水平タイプ 10 番 ヘッダーアセンブリー 10 POS DOUBLE ROW HORIZONTAL HDR ASS'Y FOR DYNAMIC 3100	
MATERIAL SEE NOTE 注記参照		FINISH SEE NOTE 注記参照		(GENERAL TOLERANCE) 100% ±0.3 100% ±0.4 30% ±0.45 70% ±0.5	
DR. 14 JUN 91 N. Matsubara		DE. 14 JUN 91 N. Matsubara		SIZE A3 LOC J NUMBER C-178305	
CHK. 24/FEB/92 M. Oshita		APP. 4/MAR/92 S. MANABE		SCALE 2-1 REV. C SHEET 1 OF 1	

(CUSTOMER DRAWING) 顧客用図面